

ステンレスファイバー充填静電気対策用 導電性コンパウンド「SUSTEC」^{*1}

阪本 良藏^{*2} 小森 英一^{*3}

Electro Conductive Plastic Compound Containing Stainless

一方、金属繊維を充填したコンパウンドで一般に懸念される成形機ならびに金型の摩耗については、サステックの使用実績の一例としてつぎのようなユーザー実績があるので紹介する。

射出成形機の場合、窒化処理された射出シリンダーの摩耗量は、一般に使われるガラス繊維充填コンパウンドと比べ、およそ1/5以下、またブリハートン鋼で製作された金型については、3万ショット使用後の時点での製作時とほとんど変化がないという。この点についても生産性向上の面で大きな効果がある。

5 用途

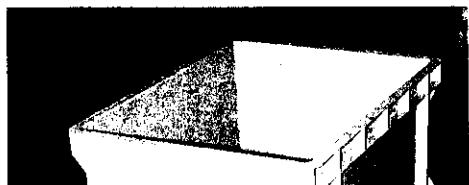
Table 3にサステックの応用例を示す。

現在、応用製品として実績が出はじめているものに、半導体の熱処理工程で使用される耐熱トレイならびに出荷用の汎用トレイがある。耐熱トレイは繰り返し使用ができること、他の工程も含めて高精度で、価格も2段階式、幅広い形状に対応する、其他の

3 導電性

設けられているが、ユーザーから好評を得ている。

その他、電子回路基板あるいは電子部品のシステム倉庫用の導電性トレイ等、ニーズに応じたカスタマイズされた製品がある。



6 おわりに

サステックは樹脂と当社の素材であるステンレスファイバーを複合化した従来にない新しいコンパウンドであり、優れた導電性、環境耐性、オーバーホールスコープ等の特徴を併せ持つ。今後も、